

PG 300WT 矽晶圓厚度量測儀

PG300WT 是由Pegasus最新研究開發的一款半導體矽晶圓厚度的測量設備。該設備採用了高精度非接觸電容式探頭,可對樣品進行無損及快速的厚度測量。通過觸控面板控制及設定參數,設備內建軟體可計算多點厚度,及5點TTV等功能。

■ 特點:

- 觸控面板操作,並顯示測量結果
- 支援5點TTV及厚度量測功能
- 可量測晶棒切片,蝕刻片,研磨片,抛光片及 帶有圖形的矽晶圓
- 無需無摩室等級即可操作量測
- 桌上型設計, 俐落且便於操作

主要測量材料:

- 矽晶圓 Si
- 碳化矽 SiC
- 鍺 Ge
- 磷化銦 InP
- 砷化鎵 GaAs
- 氮化鎵 GaN

PG300WT手動 矽晶圓厚度量測儀



設備規格

• 厚度測量範圍: 700um to 1200um • 測試樣品尺寸: 75mm to 300mm

• 精度:±0.5um • 重複性:±0.5um

解析度: 0.1um
● 探頭量測直徑: 5mm

• 操作方式:觸控螢幕 • 尺寸:389mm*374mm*365mm

QUATEK int'l. Ltd. 速技先進有限公司合灣分公司